

E73-2G4M08S1C 产品规格书

nRF52840 2.4GHz BLE4.2/5.0 低功耗蓝牙模块



成都亿佰特电子科技有限公司 Chengdu Ebyte Electronic Technology Co.,Ltd.

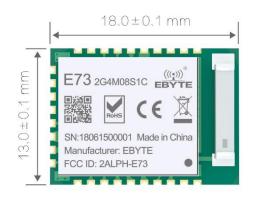


第一章 产品概述

1.1 产品简介

E73-2G4M08S1C 是亿佰特研发的小体积、低功耗的蓝牙模块,采用 Nordic 公司原装进口 nRF52840 射频芯片,支持蓝牙 4.2 和蓝牙 5.0;芯片自带高性能 ARM CORTEX-M4 内核,采用 32M 工业级晶振,并拥有 UART、I2C、SPI、ADC、DMA、PWM 等丰富的外设资源; nRF52840 引出了大部分 I/O 口,具体请查看引脚定义,方便用户进行多方位的开发。

E73-264M08S1C 为硬件平台,出厂无程序,用户需要进行二次开发; nRF52840 芯片特性请见官方 Datasheet,模块已将芯片的射频特性发挥到极致。



1.2 特点功能

- 超小体积,仅13x18mm;
- 支持 BLE4. 2 和 BLE5. 0;
- 最大发射功率 6mW, 软件多级可调;
- 支持全球免许可 ISM 2.4GHz 频段;
- 内置 32.768kHz 时钟晶体振荡器;
- ◆ 内置高性能低功耗 ARM® Cortex ® -M4 处理器;
- 丰富的资源, 1024KB FLASH, 256KB RAM;
- 支持 1.7~5.5V 供电,大于 3.3V 供电均可保证最佳性能;
- 工业级标准设计,支持-40~+85℃下长时间使用;
- 自带陶瓷天线,无需再外接天线。
- 理想条件下,通信距离可达 120m;

1.3 应用场景

- 智能家居以及工业传感器等;
- 安防系统、定位系统;
- 无线遥控,无人机;
- 无线游戏遥控器;
- 医疗保健产品;
- 无线语音,无线耳机;
- 汽车行业应用。



第二章 规格参数

2.1 极限参数

主要参数	性	:能	备注	
王安参姒	最小值	最大值	首任	
电源电压(V)	0	5.5	超过 5.5V 永久烧毁模块	
阻塞功率(dBm)	_	10	近距离使用烧毁概率较小	
工作温度(℃)	-40	+85	工业级	

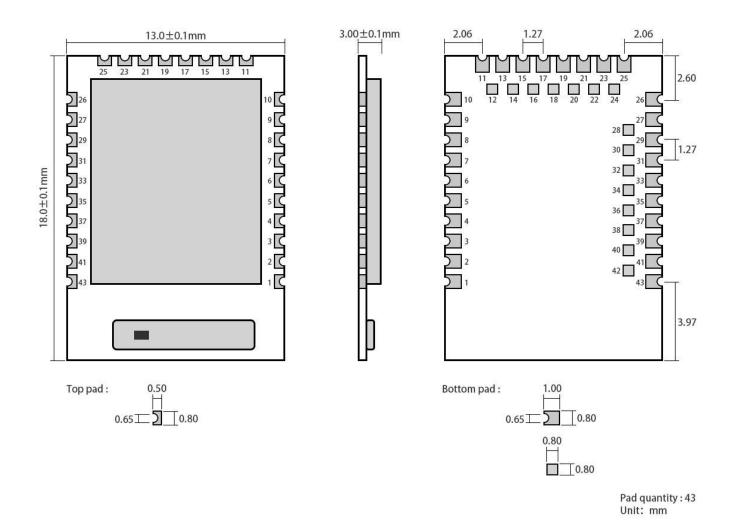
2.2 工作参数

	上 正 会 班		性能		A7 3.34-	
	主要参数	最小值	典型值	最大值	备注	
	工作电压(V)	1.7	3.3	5. 5	≥3.3V 可保证输出功率	
	通信电平(V)		3.3		使用 5V TTL 有风险烧毁	
	工作温度(℃)	-40	-	+85	工业级设计	
	工作频段(MHz)	2360	-	2500	支持 ISM 频段	
	TX only run current		17.05		A	
	(DC/DC, 3 V) PRF = $+8$ dBm		17.00		mA	
	TX only run current		10.60			
发	(DC/DC, 3 V) PRF = $+4$ dBm		12. 68		mA	
射射	TX only run current	7. 25			A	
电	(DC/DC, 5 V, REGO out = 3.3 V)PRF = 0 dBm				mA	
流	TX only run current		7. 63		mA	
1016	(DC/DC, 3 V)PRF = 0 dBm		7.05		IIIA	
	TX only run current		17. 05		mA	
	(DC/DC, 3 V) PRF = +8 dBm				III X	
接	RX only run current (DC/DC, 3 V)		7. 71		mA	
收	1 Mbps / 1 Mbps BLE		7.71		шА	
电	RX only run current (DC/DC, 3 V)	C, 3 V) 8.27			mA	
流 2 Mbps / 2 Mbps BLE			0, 21		HILL	
发射功率(dBm)		7	8	9	dBm	
	接收灵敏度(dBm)	-103dBm @ BLE 125kbps		5kbps	长距离模式	
	i安状火或反(ubili)	-95dBm @ BLE 1Mbps				



主要参数	描述	备注
参考距离	120m	晴朗空旷环境,高度 2.5 米,空中速率 1Mbps
晶振频率	32MHz/32.768KHz	
支持协议	BLE 4.2/5.0	
封装方式	贴片式	
接口方式	1.27mm	邮票孔
IC 全称	nRF52840-QIAACO/aQFN ™ 73	
FLASH	1024KB	
RAM	256KB	
内核	ARM® Cortex ® -M4	
外形尺寸	13*18mm	
天线接口	陶瓷天线	等效阻抗约 50 Ω

第三章 机械尺寸与引脚定义





引脚序号	引脚名称	对应芯片引脚名称	引脚方向	引脚用途
1	P1. 11	P1.11	通用 I/0	详见官方芯片手册
2	P1. 10	P1. 10	通用 I/0	低频 I/0,标准驱动
3	P0. 03	PO. 03/AIN1	通用 I/0	模拟量输入1,低频 I/0,标准驱动
4	AI4	PO. 28/AIN4	通用 I/0	模拟量输入4
5	GND	-	_	单地线,连接到电源参考地
6	P1. 13	P1. 13	通用 I/0	低频 I/0,标准驱动
7	AIO	PO. 02/AINO	通用 I/0	模拟量输入 0, 低频 I/0, 标准驱动
8	AI5	PO. 29/AIN5	通用 I/0	模拟量输入 5, 低频 I/0, 标准驱动
9	AI7	PO. 31/AIN7	通用 I/0	模拟量输入 7, 低频 I/0,标准驱动
10	AI6	PO. 30/AIN6	通用 I/0	模拟量输入 6, 低频 I/0, 标准驱动
11	XL1	P0.00/XL1	通用 I/0	连接 32. 768 kHz 晶体
12	P0. 26	P0. 26	通用 I/0	详见官方芯片手册
13	XL2	P0. 01/XL2	通用 I/0	连接 32. 768 kHz 晶体
14	P0. 06	P0. 06	通用 I/0	详见官方芯片手册
15	AI3	PO. 05/AIN3	通用 I/0	模拟量输入3
16	P0. 08	P0. 08	通用 I/0	详见官方芯片手册
17	P1. 09	P1. 09	通用 I/0	详见官方芯片手册
18	AI2	PO. 04/AIN2	通用 I/0	模拟量输入2
19	VCC	-	_	电源
20	P12	P0. 12	通用 I/0	详见官方芯片手册
21	GND	-	_	地线,连接到电源参考地
22	P0. 07	P0. 07	通用 I/0	详见官方芯片手册
23	VDH	VDDH	_	高压电源
24	GND	-	_	地线,连接到电源参考地
25	DCH	DCCH	_	DC/DC 转换器输出
26	RST	PO. 18/RESET	通用 I/0	QSPI/CSN/外部复位
27	VBS	VBUS	_	USB 电源, 5V 输入, 用于 USB3. 3V 稳压器
28	P15	P0. 15	通用 I/0	详见官方芯片手册
29	D-	D-	_	USB D-
30	P17	PO. 17	通用 I/0	详见官方芯片手册
31	D+	D+	_	USB D+
32	P0. 20	P0. 20	通用 I/0	详见官方芯片手册
33	P0. 13	P0. 13	通用 I/0	详见官方芯片手册
34	P0. 22	P0. 22	通用 I/0	QSPI
35	P0. 24	PO. 24	通用 I/0	QSPI
36	P1. 00	P1.00	通用 I/0	详见官方芯片手册
37	SWD	SWDIO		串行调试编程口数据
38	P1. 02	P1. 02	通用 I/0	详见官方芯片手册
39	SWC	SWDCLK	-	串行调试编程口时钟
40	P1. 04	P1. 04	通用 I/0	低频 I/0,标准驱动
41	NF1	P0. 09/NFC1	通用 I/0	NFC 输入
42	P1. 06	P1. 06	通用 I/0	低频 I/0,标准驱动



第四章 开发使用

NF2

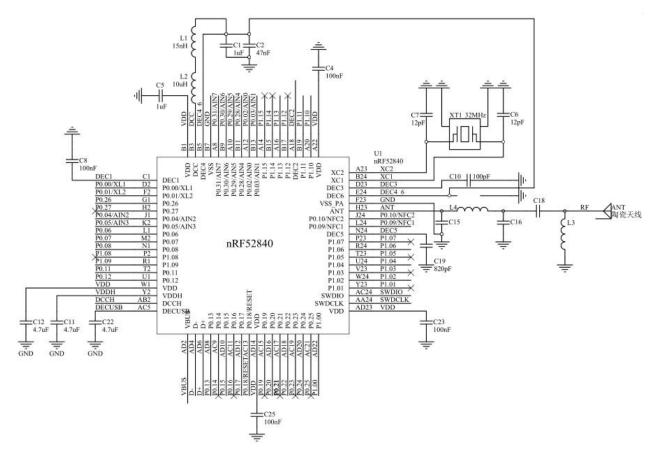
43

序号	关键字	注意事项
1	烧录程序	1. 模块内置ARM单片机,程序下载使用J-LINK下载器 ,不能使用串口或其他任何JTAG、ISP、ICP工具。 2. 程序的烧录需要两部分完成,由于NORDIC官方提供的协议栈没有加载在程序中,因此在进行二次开发的时候,需要使用官方烧录工具nRFgo studio烧录协议栈,再用nRFgo studio烧录应用代码的hex;也可以先使用官方烧录工具nRFgo studio烧录协议栈,再用IAR或者KEIL下载。官网工具下载网址:http://www.nordicsemi.com/eng/Products/Bluetooth-low-energy/nRF52832/(language)/eng-GB
2	测试底板	我司暂时没有提供配套底板。



第五章 基本操作

5.1 硬件设计及电路原理图



- 推荐使用直流稳压电源对该模块进行供电,电源纹波系数尽量小,模块需可靠接地;
- 请注意电源正负极的正确连接,如反接可能会导致模块永久性损坏;
- 请检查供电电源,确保在推荐供电电压之间,如超过最大值会造成模块永久性损坏;
- 请检查电源稳定性,电压不能大幅频繁波动;
- 在针对模块设计供电电路时,往往推荐保留30%以上余量,有整机利于长期稳定地工作;
- 模块应尽量远离电源、变压器、高频走线等电磁干扰较大的部分;
- 高频数字走线、高频模拟走线、电源走线必须避开模块下方,若实在不得已需要经过模块下方,假设模块焊接在 Top Layer,在模块接触部分的 Top Layer 铺地铜(全部铺铜并良好接地),必须靠近模块数字部分并走线在 Bottom Layer;
- 假设模块焊接或放置在 Top Layer, 在 Bottom Layer 或者其他层随意走线也是错误的,会在不同程度影响模块的杂散以及接收灵敏度;
- 假设模块周围有存在较大电磁干扰的器件也会极大影响模块的性能,根据干扰的强度建议适当远离模块,若情况允许可以做适当的隔离与屏蔽;
- 假设模块周围有存在较大电磁干扰的走线(高频数字、高频模拟、电源走线)也会极大影响模块的性能,根据干扰的强度建议适当远离模块,若情况允许可以做适当的隔离与屏蔽;
- 通信线若使用 5V 电平,必须串联 1k-5.1k 电阻(不推荐,仍有损坏风险);



- 尽量远离部分物理层亦为 2.4GHz 的 TTL 协议,例如: USB3.0;
- 天线安装结构对模块性能有较大影响,务必保证天线外露,最好垂直向上。当模块安装于机壳内部时,可使用优质的天 线延长线,将天线延伸至机壳外部;
- 天线切不可安装于金属壳内部,将导致传输距离极大削弱。

第六章 常见问题

6.1 传输距离不理想

- 当存在直线通信障碍时,通信距离会相应的衰减;
- 温度、湿度,同频干扰,会导致通信丢包率提高;
- 地面吸收、反射无线电波,靠近地面测试效果较差;
- 海水具有极强的吸收无线电波能力, 故海边测试效果差;
- 天线附近有金属物体,或放置于金属壳内,信号衰减会非常严重;
- 功率寄存器设置错误、空中速率设置过高(空中速率越高,距离越近);
- 室温下电源低压低于推荐值, 电压越低发功率越小;
- 使用天线与模块匹配程度较差或天线本身品质问题。

6.2 模块易损坏

- 请检查供电电源,确保在推荐供电电压之间,如超过最大值会造成模块永久性损坏;
- 请检查电源稳定性, 电压不能大幅频繁波动;
- 请确保安装使用过程防静电操作,高频器件静电敏感性;
- 请确保安装使用过程湿度不宜过高,部分元件为湿度敏感器件;
- 如果没有特殊需求不建议在过高、过低温度下使用。

6.3 误码率太高

- 附近有同频信号干扰,远离干扰源或者修改频率、信道避开干扰;
- 电源不理想也可能造成乱码, 务必保证电源的可靠性;
- 延长线、馈线品质差或太长, 也会造成误码率偏高。

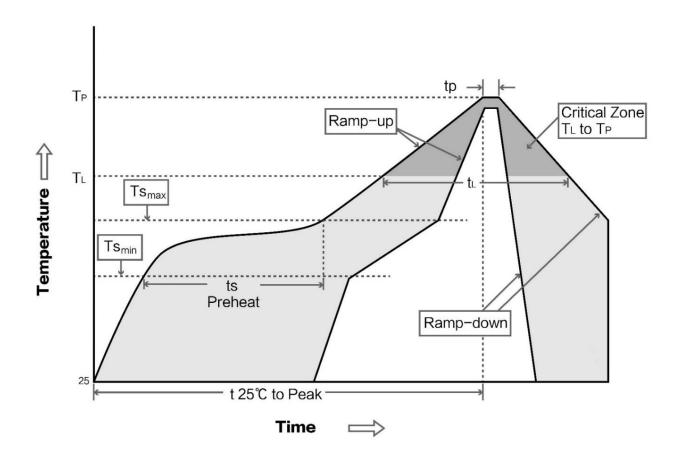


第七章 焊接作业指导

7.1 回流焊温度

Profile Feature	曲线特征	Sn-Pb Assembly	Pb-Free Assembly
Solder Paste	锡膏	Sn63/Pb37	Sn96. 5/Ag3/Cu0. 5
Preheat Temperature min (Tsmin)	最小预热温度	100℃	150℃
Preheat temperature max (Tsmax)	最大预热温度	150℃	200℃
Preheat Time (Tsmin to Tsmax)(ts)	预热时间	60-120 sec	60-120 sec
Average ramp-up rate(Tsmax to Tp)	平均上升速率	3℃/second max	3℃/second max
Liquidous Temperature (TL)	液相温度	183℃	217℃
Time(tL)Maintained Above(TL)	液相线以上的时间	60-90 sec	30-90 sec
Peak temperature(Tp)	峰值温度	220−235℃	230-250℃
Aveage ramp-down rate(Tp to Tsmax)	平均下降速率	6℃/second max	6℃/second max
Time 25℃ to peak temperature	25℃到峰值温度的时间	6 minutes max	8 minutes max

7.2 回流焊曲线图

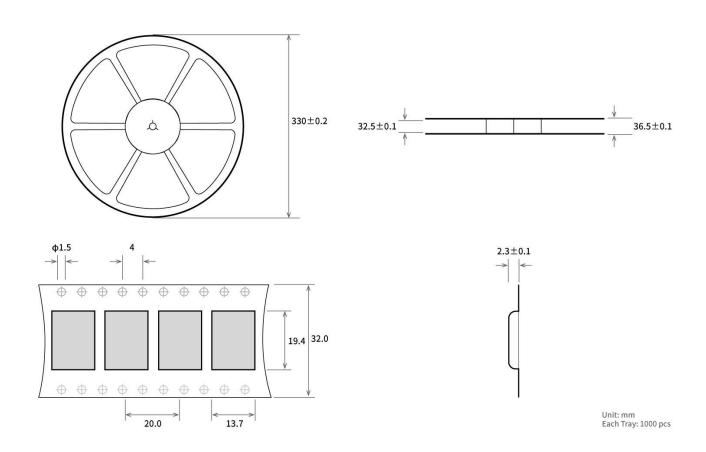




第八章 相关型号

产品型号	芯片方案	载波频率 Hz	发射功率 dBm	蓝牙协议 BLE	产品尺寸 mm	封装形式	天线形式
E73-2G4M04S1A	nRF52810	2.4G	4	4. 2/5. 0	17. 5*28. 7	贴片	PCB/IPX
E73-2G4M04S1B	nRF52832	2.4G	4	4. 2/5. 0	17. 5*28. 7	贴片	PCB/IPX
E73-2G4M08S1C	nRF52840	2.4G	8	4. 2/5. 0	13*18	贴片	陶瓷天线
E73-2G4M04S1D	nRF51822	2.4G	4	4. 2	17. 5*28. 7	贴片	PCB/IPX

第九章 批量包装方式





修订历史

版本	修订日期	修订说明	维护人
1.0	2018-8-30	初始版本	huaa
1.1	2018-9-28	版本拆分	huaa
1.4	2018-11-6	版本更新	huaa
1.5	2019-2-19	错误修正	Ray
1.6	2019-4-15	版本更新	Ray

关于我们



销售热线: 4000-330-990 公司电话: 028-61399028 技术支持: <u>support@cdebyte.com</u> 官方网站: www.ebyte.com 公司地址: 四川省成都市高新西区西芯大道 4 号创新中心 B333-D347

